

Title (en)
ETCHING SOLUTION.

Title (de)
ÄTZLÖSUNG.

Title (fr)
SOLUTION D'ATTAQUE.

Publication
EP 0536362 A1 19930414 (DE)

Application
EP 92908839 A 19920421

Priority
• DE 9200321 W 19920421
• DE 4113283 A 19910424

Abstract (en)
[origin: WO9219792A1] An etching solution for removing a metallic layer from a substrate contains a hydrogenated compound that dissolves the metal itself while evolving hydrogen and a nitro-substituted organic compound. The solution is characterized by the fact that the selected nitro-substituted organic compound is a compound having an easily hydrogenizable nitro group.

Abstract (fr)
Une solution d'attaque qui sert à enlever une couche métallique déposée sur un substrat contient un composé hydrogéné qui dissout le métal proprement dit tout en dégageant de l'hydrogène et un composé organique à substitution nitro. La solution se caractérise par le fait que l'on sélectionne comme composé organique à substitution nitro un composé dont le groupe nitro est facile à hydrogéner.

IPC 1-7
C23F 1/44

IPC 8 full level
C23F 1/10 (2006.01); **C23F 1/20** (2006.01); **C23F 1/26** (2006.01); **C23F 1/28** (2006.01); **C23F 1/36** (2006.01); **C23F 1/44** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C23F 1/10 (2013.01 - EP US); **C23F 1/20** (2013.01 - EP US); **C23F 1/26** (2013.01 - EP US); **C23F 1/28** (2013.01 - EP US);
C23F 1/36 (2013.01 - EP US); **C23F 1/44** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
See references of WO 9219792A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR LI NL

DOCDB simple family (publication)
WO 9219792 A1 19921112; AT E140041 T1 19960715; DE 4113283 A1 19921029; DE 4113283 C2 19940505; DE 59206696 D1 19960808;
EP 0536362 A1 19930414; EP 0536362 B1 19960703; JP H06500363 A 19940113; US 5462640 A 19951031

DOCDB simple family (application)
DE 9200321 W 19920421; AT 92908839 T 19920421; DE 4113283 A 19910424; DE 59206696 T 19920421; EP 92908839 A 19920421;
JP 50795692 A 19920421; US 96280192 A 19921222